

非シリコン熱伝導性グリース

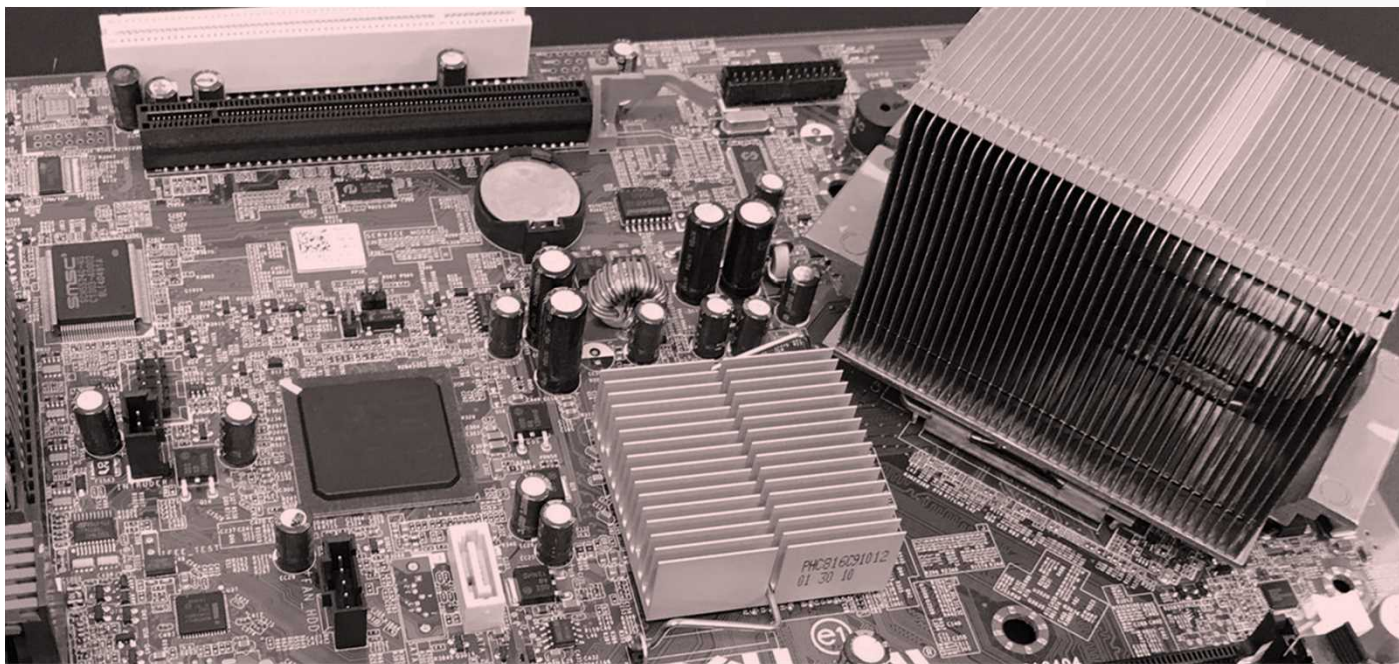
TG200シリーズ

高热伝導 ・ 低熱抵抗 ・ ノンシリコン

- 非シリコン系の熱伝導性グリース。
- シロキサンなどの揮発分がなく、耐熱性に優れている。
- 熱抵抗0.05℃/Wから、熱伝導率6W/m・Kと多数ラインアップ

Thermally Conductive Compound

TG200 series



● 一般特性

項目	TG221	TG221C	TG240	TG260	試験方法
外観	白色、グリース状	白色、グリース状	白色、グリース状	白色、グリース状	—
比重	2.9	2.9	3.4	3.6	—
熱伝導率(W/m・K)	2	2	4	6	ASTM D 5470
最小熱抵抗(℃/W)	0.05 (5μm)	0.05 (5μm)	0.10(30μm)	0.10 (30μm)	ASTM D 5470 (荷重500kPa)
粘度(Pa・s)	110	140	180	280	E型粘度計/3rpm
ちょう度	300	280	280	210	JIS K 2220
離油度(%)	0	0	0	0	JIS K 2220
体積抵抗率(Ω・cm)	> 10 ¹²	> 10 ¹²	> 10 ¹²	> 10 ¹²	JIS C 2101
使用可能温度	-40℃~125℃	-40℃~125℃	-40℃~120℃	-40℃~120℃	—
使用期限	-40℃~40℃ 製造後15ヶ月	-40℃~40℃ 製造後12ヶ月	25℃以下 製造後6ヶ月	25℃以下 製造後6ヶ月	—
特色	薄膜良好	薄膜良好	塗布性良好	高热伝導率	—

ここに記載された事項は、細心の注意を払って行った実験に基づくものですが、実際の現場結果を保証するものではありません。また、ご使用の際には必ず安全データシート（SDS）をよくお読みの上、お取扱いください。

非シリコン熱伝導性グリース

TG200シリーズ

高熱伝導・低熱抵抗・非シリコン

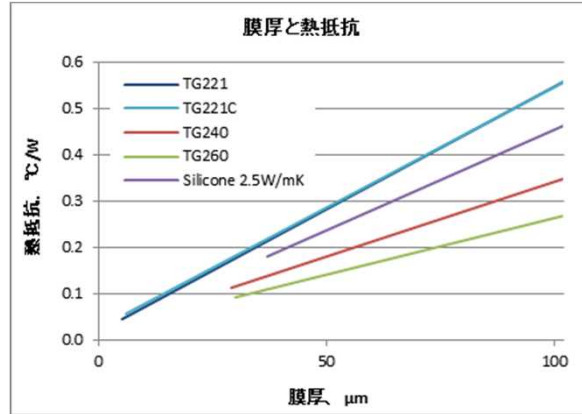
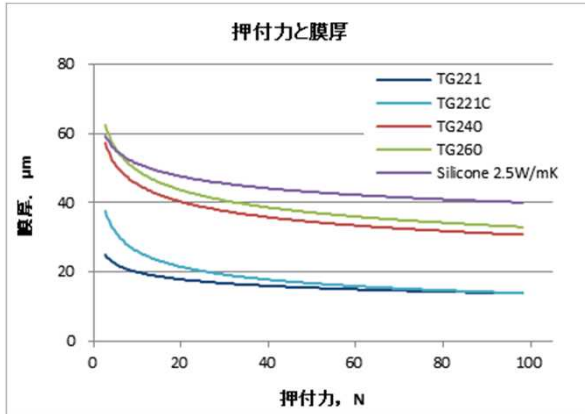
非シリコン・薄膜塗布・低熱抵抗

低荷重薄膜化が可能

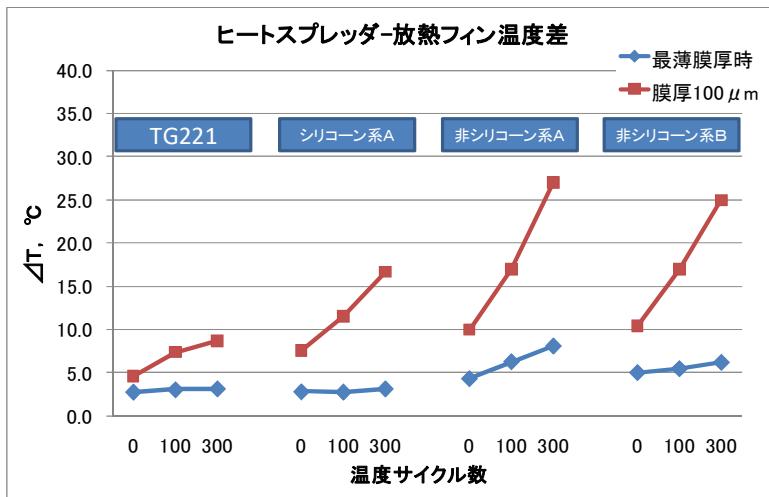
TG221、TG221C (2W/m・K) は軽い荷重でも良く拡がり膜厚を薄くすることができます。TG240 (4W/m・K) TG260 (6W/m・K) は薄膜化が難しい高熱伝導タイプですがシリコン系 2.5W/m・K品より薄膜化が可能です。

薄膜化による低熱抵抗が可能

TG221、TG221Cは薄膜塗布性が優れており膜厚を薄くすることができる場合は熱抵抗を低く抑えることが可能です。TG240、TG260は膜厚が厚い場合でも熱抵抗の上昇が少なく良好な熱伝導を保ちます。



TG221の熱伝導特性



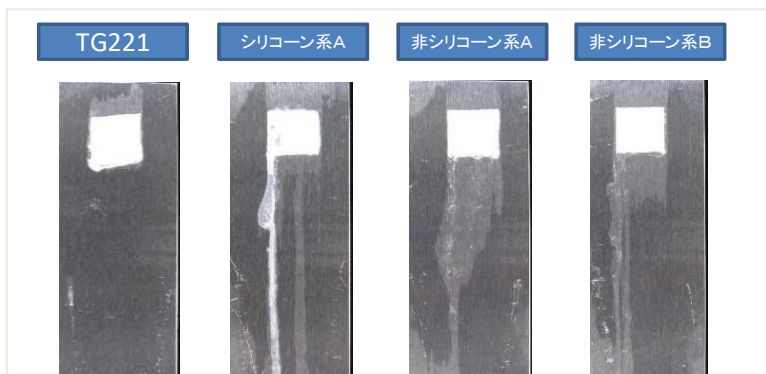
<評価方法>

実際の使用状態に合わせ、発熱体と放熱フィンの上にグリースを塗布して温度を測定した。

<結果>

TG221はヒートスプレッダと放熱フィンとの温度差ΔTが少なく熱伝導特性に優れていることが分かります。

TG221垂直設置時の垂れ落ち



<評価方法>

実際の使用状態に合わせ、アルミ板にグリースを塗布し、垂直設置して温度サイクル試験 (-40℃⇔125℃) を行った。

<結果>

TG221はしみだしや垂れ落ちが少なく垂直設置時のグリース抜けが少ないことが分かります。

Thermally Conductive Compound

TG200 series